

# 高速接地插座

## 技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 [www.samtec.com?QSH](http://www.samtec.com?QSH)

绝缘体材料:

液晶

聚合物

触点材料:

磷青铜

电镀:

在 50μ" (1,27μm) 的镍上

镀金或锡

额定电流:

触点: 30°C 温升时为 1.0A

接地板: 30°C 温升时为 7.8A

工作温度范围:

-55°C 至 +125°C

额定电压:

125 VAC (5mm 堆叠高度)

最大次数:

100

拔出 (-RT1 选项):

-RT1 选择增加拔出出力多达 50%

符合 RoHS 规范要求:

是

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面性:

(0,10mm) .004" 最大 (030-060)

(0,15mm) .006" 最大 (090-120)

电路板相叠:

有关每块电路板需要两个连接器

或 4 列或更多列的应用,

请联系 [ipg@samtec.com](mailto:ipg@samtec.com)

## 特殊应用选项

- 14mm、15mm、22mm 和 30mm 堆叠高度 (小心: 有些自动放置/插入机械可能有元件高度限制。请参考机械技术规格。)
  - 30μ" (0,76μm) 金 (为数据速率线缆连接应用指定 -H 电镀。)
  - 边缘安装和导柱
  - 每排 150 个位置
- 请致电 Samtec。

\*注: -C 电镀通过 10 年 MFG 测试

注: 有些长度、式样和选项为非标准型, 不可退换。

电路板配接:  
QTH

缆线配接:  
HFHM2、HQCD、  
HQDP  
(参见特定  
应用的注释)



| 5mm 堆叠高度 | 类型  | 在 3dB 插入损耗的额定值    |
|----------|-----|-------------------|
| 单端信号     | -D  | 9 GHz / 18 Gbps   |
| 差分对信号    | -D  | 8 GHz / 16 Gbps   |
| 差分对信号    | -DP | 9.5 GHz / 19 Gbps |

如需完整测试数据, 请浏览 [www.samtec.com?QSH](http://www.samtec.com?QSH) 或联系 [sig@samtec.com](mailto:sig@samtec.com)

QSH

每排引脚数  
对数

01

电镀选项

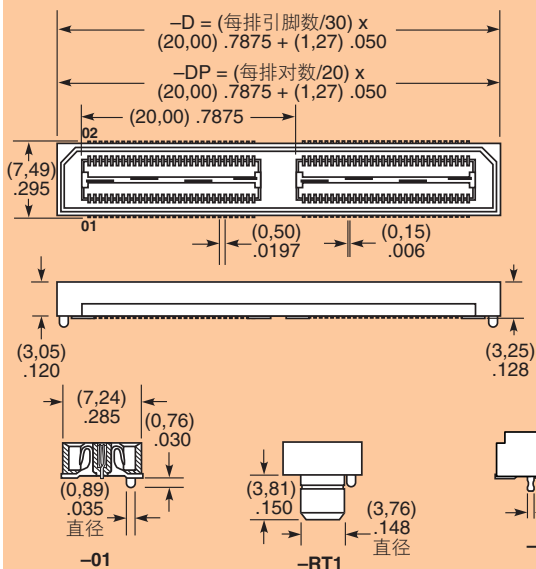
类型

A

其他选项

-030, -060, -090, -120  
(每列总共 60 个引脚 = -D)

-020、-040、-060、-080  
(每列 20 对 = -D-DP)



-F

= 在信号引脚  
和接地板上镀金膜  
焊尾镀锡

-L

= 在信号引脚和  
接地板上镀  
10μ" (0,25μm) 的金  
焊尾镀锡

-C\*

= 可选电镀  
在触点区域的信号引脚  
上镀 150μ" (3,81μm)  
的镍, 之上最少镀  
50μ" (1,27μm) 的金,  
在触点区域的接地板上  
镀 50μ" (1,27μm) 的  
镍, 之上最少镀 10μ"  
(0,25μm) 金,  
在所有焊尾上镀最少  
50μ" (1,27μm) 镍,  
之上镀锡

-D

= 单端

-D-DP  
= 差分对  
(仅限 -01)

-K

= (8,25mm)  
.325" 直径  
聚酰亚胺膜取  
放垫

-TR

= 卷带封装  
(-090 最大  
位置数)

-RT1

= 固定选择  
(-090 最大  
位置数)

-L

= 锁紧选项  
(对 -120 或  
-RT1 不提供)

| QTH<br>引线式样 | 与 QSH 的配接<br>高度* |
|-------------|------------------|
| -01         | (5,00) .197      |
| -02         | (8,00) .315      |
| -03         | (11,00) .433     |
| -04         | (16,00) .630     |
| -05         | (19,00) .748     |
| -07         | (25,00) .984     |

\*加工条件将影响配接高度。